上海硅产业集团股份有限公司

投资者关系活动记录表

股票名称：沪硅产业 **股票代码：688126**

投资者关系活动类别	□特定对象调研 ☐分析师会议 □媒体采访 ☑业绩说明会 □新闻发布会 ☐路演活动 □现场参观 ☑电话会议
参与单位/个人	国信证券、中金公司、华泰证券、天风证券、浙商证券、国金证券等机构投资者及个人投资者通过电话和网络参加会议。
时间	2026 年 11 月 2 日
地点	线上交流
公司接待人员	邱慈云、李炜、黄燕、方娜
投资者关系活动主要内容介绍	1、半导体行业及公司 2026 年第三季度经营情况介绍 2026 年前三季度，公司实现营业收入 36.37 亿元，同比增长 37.69%；第三季度单季实现营业收入 13.19 亿元，同比增长 39.81%。其中，300mm 半导体硅片收入同比增长超过 45%，继续成为公司收入增长的主要动力；200mm 及以下硅片收入同比增长近 30%，为公司整体营收增长提供了有力支撑。 利润层面来看，第三季度单季公司实现归属于上市公司股东净利润扭亏为盈，主要来自战略配售相关公允价值变动收益的贡献；但是，扣非净利润仍处亏损状态，主要是近年布局的新建项目仍在产能爬坡阶段，固定成本压力以及价格修复效应的滞后对利润端造成了一定的压力。此外，持续的高强度研发投入以

	及欧元汇率波动带来的汇兑损失也对扣非净利润的改善造成了一定的影响。 300mm 半导体硅片业务方面，公司持续推进产能释放、客户认证，产品良率、正片率都在持续提升。除了保持在国内的领先优势外，公司还持续积极拓展海外客户，并在海外头部 IDM 的高端产品认证与正片供货方面取得实质进展。随着产销量增长，公司 300mm 半导体硅片的环比亏损也在持续改善。 200mm 及以下半导体硅片业务方面，新傲科技结合下游市场需求，持续调整产品结构、优化客户订单，稳住基本盘、稳住现金流，保障公司 200mm 外延业务的平稳发展。芬兰 Okmetic 也看到了高端业务的回流，正在积极争取改善正片/测试片的比例。 此外，300mm SOI、压电薄膜，与 200mm 高端 MEMS 衬底材料等具有特色的硅片产品的产线建设也在快速推动中，并将在年内形成一定的规模。同时，300mm SOI 业务在射频、高压、硅光等客户端的认证也都取得了较好的进展，随着在产能端、客户端持续取得进展，后续也将成为公司新的增长曲线。 下一阶段，公司将继续推进产能建设与爬坡，全力推进 2026 年底 300mm 半导体硅片 120 万片/月的产能建设目标的实现，持续提升产品良率和正片率，优化产品销售结构。同时，加快高端硅片及 300mm SOI 等产品的研发、客户认证和市场拓展，积极把握行业需求增长与价格修复带来的机遇。同时，公司还将加强成本费用管控，深化集团化精细管理，把改善主营业务盈利水平作为核心经营目标，推动产能和技术优势向经营效益转化。

	2、交流问答 问 1：公司如何看待近期半导体硅片价格变化趋势，以及新一轮长协谈判中的价格调整情况？ 答：今年上半年，国内半导体硅片价格逐步触底，随着市场供需关系改善，部分产品价格开始修复，进入上升通道。对于长协以外的增量及新产品，我们会根据市场情况与客户协商价格；对于长协以内的产品，我们目前正在与客户就明年乃至未来价格安排进行沟通与确认，积极推动价格的调整。经过本轮价格调整后，预计将在后续的 ASP 数据上陆续看到一定的改善趋势。总体来说，公司将在保持长期稳定合作的基础上，积极争取合理的价格调整空间。 问 2：公司如何看待明年毛利率的改善趋势？ 答：今年以来，公司始终在积极推进毛利的逐步改善，并逐季取得了一定的成果。目前公司的毛利改善的主要贡献还是来自于 300mm 半导体硅片，主要有两个方面的原因：一是相关产能利用率已达到较高水平，规模效应逐步体现；二是持续推进降本增效，相关措施的成效已逐步显现。未来，公司将继续加强成本费用管控，全方位提高经营效率，推动毛利水平持续改善。 问 3：公司对于海外客户拓展有哪些规划？ 答：公司始终重视国际市场的开发与布局，近年来持续推进客户认证和市场拓展，在海外特别是欧洲市场已经有了较大的进展，并在部分客户处获得了 300mm 半导体硅片高端正片订单。同时，芬兰 Okmetic 依托长期积累的国际客户资源和销售渠道，持续拓展

	200mm 特色硅片业务，并为公司 300mm 硅片开拓国际市场提供支持。公司将继续深化与现有海外客户的合作，丰富产品供应种类、拓展应用领域，同时积极开发新的海外客户，进一步提升国际市场竞争力。 问 4：公司的产能规划目标年内是否能达成？是否有后续考虑？ 答：300mm 硅片 120 万片/月的产能建设目标一直推进的比较顺利，将在今年年底达成建设目标，并陆续实现产能释放。后续的产能规划将结合市场应用端的需求走势，进行审慎的考虑，如有明确的方案，将在履行内部审议程序后进行披露。 问 5：未来公司对不同下游客户的战略布局考虑会在哪些方面？ 答：公司始终致力于拓展半导体硅片产品和技术覆盖的广度与深度，已形成较为全面的产品布局。随着公司产能规模不断扩大，一方面，公司将继续深化与现有客户的合作，更好地满足其产品及供货需求；另一方面，对于具有明确产品和技术需求的新客户，公司也将积极推进合作。同时，公司将持续开拓国际市场，进一步扩大客户覆盖范围。从公司内部来说，也会在发展过程中，向研发部门倾斜一定的资源，尽可能完整的覆盖产业客户在不同应用领域的需求。 问 6：公司 300mm SOI 业务的发展情况如何？ 答：与 300mm 大硅片所处的阶段不同，300mm SOI 业务目前仍处于客户端认证、产能爬坡和产品逐步上量的阶段。目前，300mm SOI 产品主要面向硅光、射

	频、高压等应用领域，从目前的下游应用领域来看，硅光应用的放量确实比较快。但整体来说，SOI 硅片在全球硅材料产业的占比目前还是小于硅片，但在部分应用领域又是不可或缺的存在。公司将积极抓住机遇，持续推进产品技术研发与客户认证，通过发挥自身的技术积累优势以及国内独有的优势，争取让 SOI 早日为公司业绩做出贡献，也进一步完善公司在国内硅材料领域全覆盖的战略布局。 问 7：公司对中长期的行业地位及发展目标有何考虑？ 答：公司致力于成为具有国际竞争力的半导体硅材料企业，持续向“一站式”硅材料综合服务商的发展目标迈进。未来，公司将继续加强核心技术研发，完善全尺寸、全品类的半导体硅片产品布局，不断提升产品质量、生产交付和客户服务能力，积极拓展国内外市场，进一步增强在全球半导体硅片市场的综合竞争力。
附件清单（如有）	
日期	2026 年 11 月 2 日